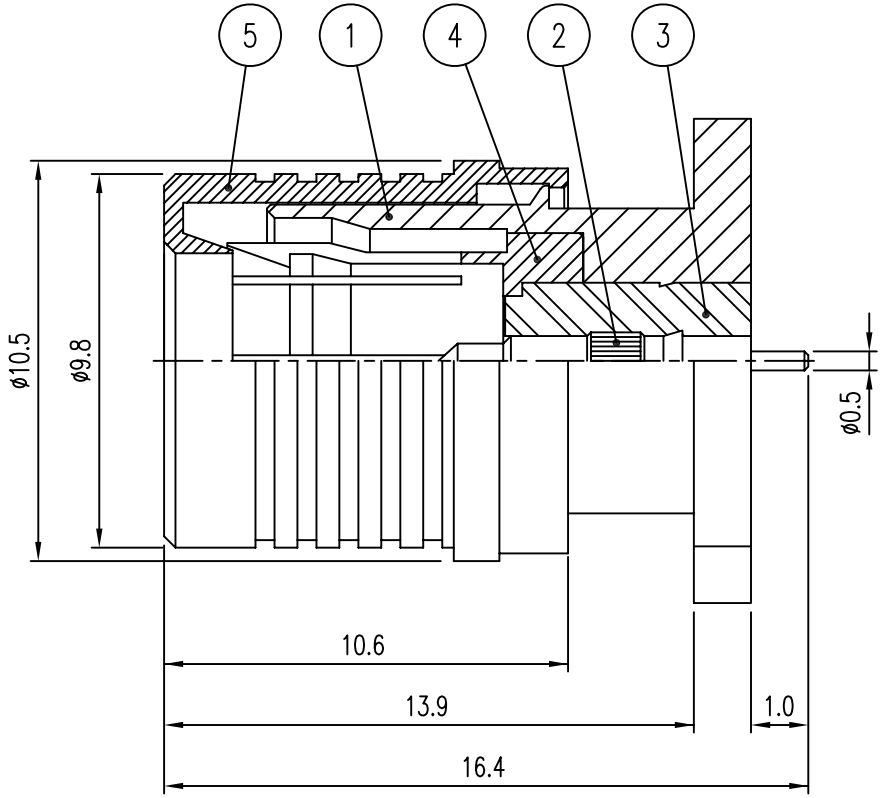
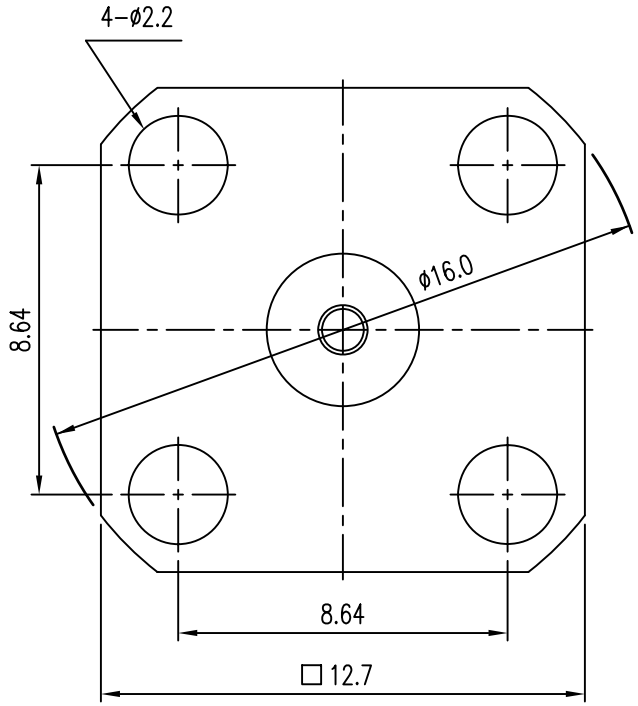
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	(설변No.201504-0006) BODY 표준화 치수 변경 및 TEFLON, JACK, CAP 코드 변경	H.J.LEE	I.C.KIM	2015. 04. 23.
2	(설변No.201806-0002) QMA 표준화 치수 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018. 06. 11.





	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
△1	5	CAP	1	MBsBD	SUCO Plate	DCU02169-5/1
△2 △1	4	JACK	1	BeCu	SUCO Plate	DJA00209-5/4 ~~DJA00209-5/2~~
△1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02585-N/1
	2	CONTACT	1	BeCu	SUCO Plate	DCT03473-5/1
△1	1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate	DBD01213-5/2

* 조립주의 *

- CAP 조립시 JACK이 눌리지 않도록 HAND PRESS 및 AIR PRESS 등 조절하여 작업 할 것 (조립 가능한 최소거리 설정)

대체가능재질	년월일	2018. 06. 11.	KJ COMTECH KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
공통공차 소수 각도 분수	승인	I.C.KIM	
재질	검도		도명 KQMA50 SOLDER END PS-4H
열처리	제도	S.Y.EUN	
보호피막처리	작성부서	연 구 소	A4 도번 CN00853-7/3
	척도 5/1	단위 mm	중량 ___